目　　录

.....1
.....1
.....1
.....2
.....2
1．仪器仪表的选择与使用.....2
2. 电子元器件的识别和检测.....2
3．电子工程图的识读.....3
4．常用装配工具的选择与使用.....3
5．电子产品工艺文件的使用.....4
6．电子元器件的预处理与插装.....4
7. 电子线路的手工焊接.....5
8．电子产品的电路调试.....6
9．电子产品的电路故障检修.....6
10．电子产品装配质量检验.....7
.....9
1．硬件电路的手工装配.....9
2．硬件电路调试.....9
3．仪器仪表选择和操作.....10
4. 常用工具软件的使用.....11
5. 工艺文件编写.....11
6 程序代码编写.....12
.....13
.....13
1. 电子元器件的识别和测试.....13
2．仪器仪表的选择与使用.....14
3．电子工程图的识读.....14
4. 程序代码编写.....15
5. 嵌入式系统综合调试与测试.....15
.....17
1. 移动应用开发环境搭建.....17
2. 移动应用 UI 设计.....17
3. 移动应用人机交互设计.....18
4. 移动应用程序代码编写.....19
5. 移动应用程序综合调试.....19
..... 21
1 21
2 21
3 21

..... 25
1 25
2 25
3 26
..... 26

610115

1. 仪器仪表的选择与使用

2. 电子元器件的识别和检测

3．电子工程图的识读

4．常用装配工具的选择与使用

5．电子产品工艺文件的使用

6．电子元器件的预处理与插装

7. 电子线路的手工焊接

8．电子产品的电路调试

9．电子产品的电路故障检修

10．电子产品装配质量检验

1．硬件电路的手工装配

3．仪器仪表选择和操作

4. 常用工具软件的使用

5. 工艺文件编写

6 程序代码编写

1. 电子元器件的识别和测试

4. 程序代码编写

5. 嵌入式系统综合调试与测试

1. 移动应用开发环境搭建

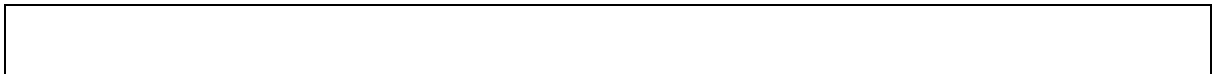
2. 移动应用 **UI** 设计

3. 移动应用人机交互设计

4. 移动应用程序代码编写

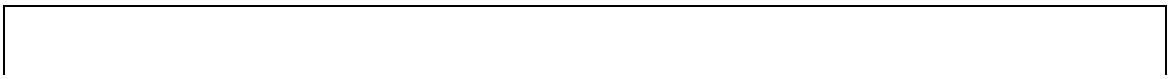
5. 移动应用程序综合调试

1



				0
			6S	

				0
			6S	



3

2

表 2 考核内容与考核方式

					( )
					180
					180
		STM32	STM32		120
		AndroidStudio	AndroidStudio		120